

台积电营收创历史新高，T-glass供不应求

半导体行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年03月03日

- 分析师：吕卓阳
- SAC编号：S1050523060001

研究创造价值

台积电营收创历史新高，先进制程产能成为全球稀缺资源

台积电 2025 年营收突破 3.8 万亿新台币（约合人民币 8500 亿 +），创历史新高；2024-2025 年合计获各国政府补助 1514.22 亿新台币，成为美、日、德、中四大经济体争相用补贴争取的企业，各国通过资金投入换取芯片产能与供应链安全，为台积电全球建厂提供了重要资金支撑。此外，台积电在全球范围内加速建厂进度，面对关税威胁与地缘博弈的双重夹击，台积电通过在在中国台湾、美国、日本、中国大陆以及德国等地区布局产能，巧妙地开启了去风险化进程。对于台积电而言，3nm、2nm甚至未来的1.6nm制程，已经不再是试验性的技术指标，而是全球科技巨头争相抢购的稀缺资源。

T-glass供不应求，成为制约人工智能硬件的关键因素

随着人工智能芯片封装和基板尺寸的增大，以适应更高的计算能力（采用更多HBM内存和芯片组），支撑它们的集成电路基板也必须随之增大，但必须谨慎操作，避免翘曲陷阱，因此需要使用低热膨胀系数（CTE）的玻璃纤维。英伟达尤其提前一年多就预订了玻璃纤维布产能，远早于批量发货时间。而苹果、谷歌和亚马逊云服务等其他公司也在为争夺剩余的产能而展开激烈竞争。然建造一座新的玻璃熔炉大约需要两年的建设和调试时间。T-Glass 的延迟导致用于 CoWoS 封装的基于 ABF 的 IC 基板的交付周期延长。预计T-Glass的供不应求的态势将维持。

建议关注：中芯国际、华虹公司、中材科技、宏和科技。

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

产先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026-02-27 股价	EPS			PE			投资评级
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E	
002080.SZ	中材科技	50.63	0.53	1.17	1.6	95.26	43.14	31.66	未评级
603256.SH	宏和科技	79.79	0.03	0.22	0.34	2659.67	369.06	236.13	未评级
688347.SH	华虹公司	126.78	0.22	0.32	0.64	576.27	396.68	196.83	未评级
688981.SH	中芯国际	115	0.46	0.63	0.77	250.00	182.54	148.93	买入

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

目录

CONTENTS

1. 半导体板块周度行情分析
2. 行业高频数据
3. 行业动态
4. 公司公告

01 半导体板块周度行情分析

研究创造价值

1.1、周涨幅排行

2月23日-2月27日当周，海外龙头总体呈上涨态势。其中，稳懋领涨，涨幅为37.40%。

图表2：海外半导体龙头估值水平及周涨幅（%）

	证券代码	证券简称	国家/地区	市值(亿元)	PE(LYR)	PB(MRQ)	周涨跌幅(%)
处理器	INTC.0	英特尔(INTEL)	美国	2278.22	-853.27	1.99	3.40
	QCOM.0	高通(QUALCOMM)	美国	1518.98	27.41	6.58	-0.36
	AMD.0	超威半导体(AMD)	美国	3264.25	75.30	5.18	0.03
	NVDA.0	英伟达(NVIDIA)	美国	43057.17	35.86	27.37	-6.65
存储	MU.0	美光科技(MICRON TECHNOLOGY)	美国	4641.26	54.35	7.89	-3.69
模拟	TXN.0	德州仪器(TEXAS INSTRUMENTS)	美国	1925.01	38.71	11.83	-3.47
	ADI.0	亚德诺(ANALOG)	美国	1736.98	76.61	5.14	0.21
	AVGO.0	博通(BROADCOM)	美国	15150.74	65.51	18.64	-3.94
	NXPI.0	恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	573.64	28.38	5.70	-2.26
射频	SWKS.0	思佳讯(SKYWORKS)	美国	89.59	18.78	1.56	0.41
	QRVO.0	QORVO	美国	76.81	138.11	2.08	0.80
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	298.71	179.95	1.68	-0.03
	ON.0	安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)	美国	261.94	216.48	3.41	-3.81
	IFX.DF	英飞凌科技	德国	595.34	58.65	3.41	1.38
光学	3008.TW	大立光	中国台湾	3363.40	12.98	1.85	10.04
半导体设备	AMAT.0	应用材料(APPLIED MATERIAL)	美国	2954.61	42.22	13.61	-0.82
	LRCX.0	拉姆研究(LAM RESEARCH)	美国	2920.75	54.51	28.79	-4.50
	KLAC.0	科天半导体(KLA)	美国	1998.33	49.20	36.56	1.91
	ASML.0	阿斯麦	荷兰	5712.75	50.74	24.86	-1.29
硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	2175.42	22.09	2.42	2.13
晶圆代工	2330.TW	台积电	中国台湾	616660.13	30.12	9.55	4.18
	GFS.0	格芯(GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	264.32	29.86	2.22	2.94
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	1432.92	186.55	3.63	37.40
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	536.38	53.25	5.14	1.38
分销	ARW.N	艾睿电子(ARROW ELECTRONICS)	美国	77.73	13.61	1.18	-3.10
	AVT.0	安富利(AVNET)	美国	53.90	22.44	1.09	-2.20

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.2、申万一级行业估值水平

2月23日-2月27日当周，申万半导体指数整体呈现震荡上行的态势。2月27日，申万半导体指数为8091.38，周涨幅为2.19%。

图表3：近5年申万半导体指数

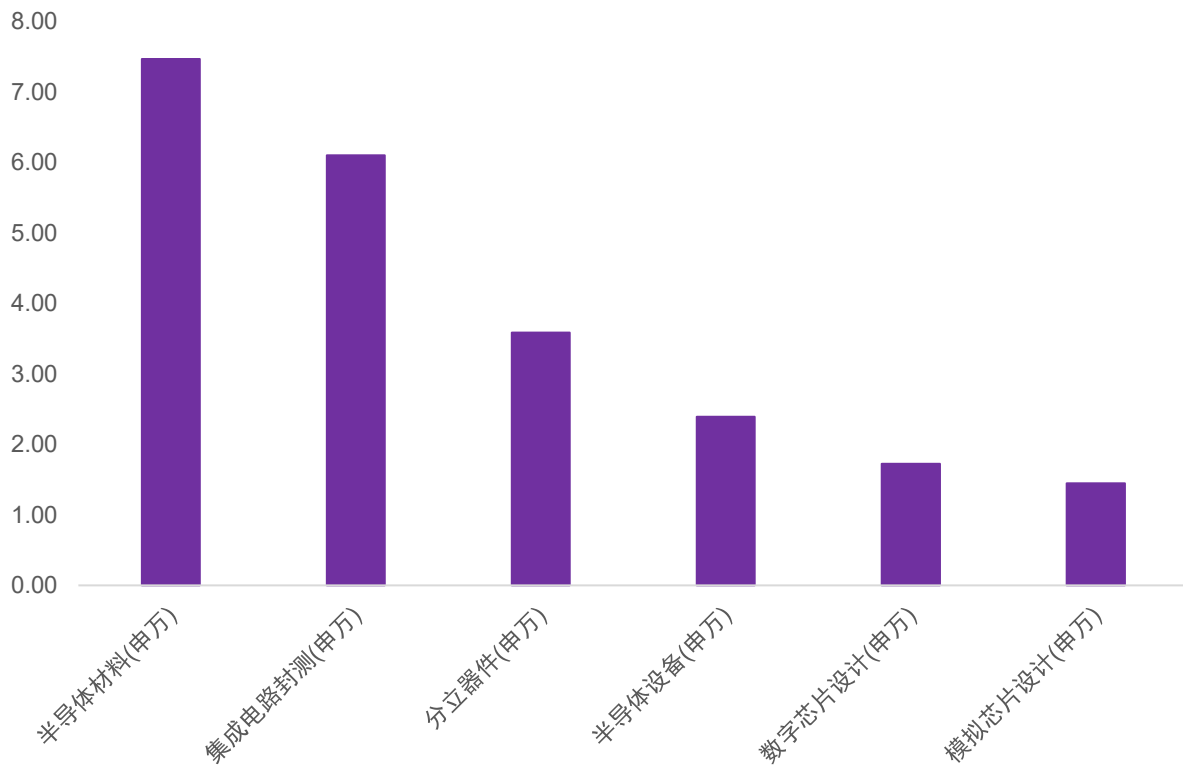


资料来源：wind，华鑫证券研究 注：按申万行业二级分类

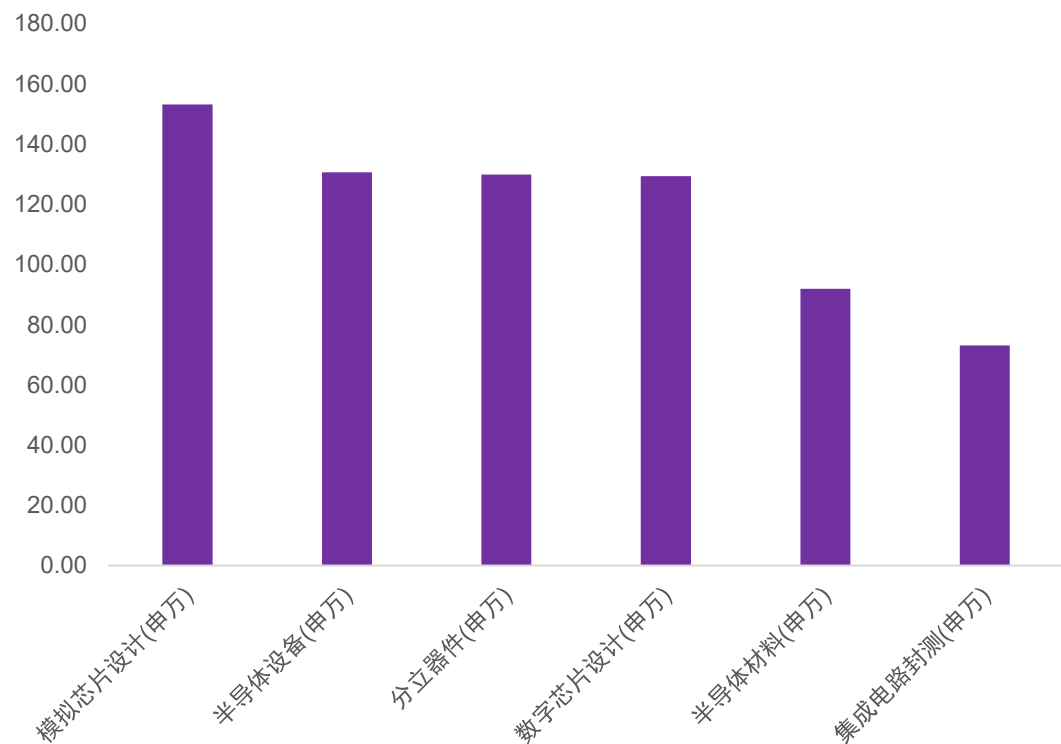
1.3、半导体细分板块周度行情梳理

半导体细分板块比较，2月23日-2月27日当周，半导体细分板块呈上涨态势。其中，半导体材料板块涨幅最大，达到7.47%；模拟芯片设计板块涨幅最小，达到1.45%。估值方面，模拟芯片设计、半导体设备、分立器件板块估值水平位列前三。

图表4：2月23日-2月27日半导体主要指数周涨跌幅比较（%）



图表5：2月27日半导体主要指数市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

1.4、申万二级行业板块资金流向

上周申万行业资金流向情况：

电子化学品板块主力净流入6.72亿元，主力净流入率为0.59%，在9个二级子行业中排第1名；其他电子板块主力净流出11.15亿元，主力净流入率为-1.36%，在9个子行业中排第9名。

图表6：2月23日-2月27日申万行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW电子化学品 II	4122550.253	4055333.563	67216.6911	0.59	-1
SW其他电源设备 II	3772372.573	3739320.297	33052.2764	0.31	2
SW半导体	36627378.94	36964760.11	-337381.1674	-0.37	-3
SW消费电子	12519690.82	12776151.48	-256460.6656	-0.81	-4
SW通信设备	27857134.96	28490852.41	-633717.4531	-1.03	-1
SW计算机设备	4746906.077	4919730.55	-172824.4719	-1.18	1
SW军工电子 II	7018822.919	7259179.196	-240356.2748	-1.23	-2
SW航天装备 II	2228012.392	2323157.621	-95145.229	-1.25	-1
SW其他电子 II	3006687.288	3118202.775	-111515.4868	-1.36	-1

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.6、半导体板块公司周涨幅前十股票

2月23日-2月27日当周，半导体板块公司周涨幅前十个股：欧莱新材，新相微，和林微纳，有研硅，长光华芯，星宸科技，赛微微电，有研新材，富创精密，气派科技，周涨幅分别为：28.30%，23.84%，22.07%，20.96%，19.24%，18.00%，16.54%，16.09%，14.17%，13.78%。

图表7：半导体板块公司周涨幅前十股票

证券代码	证券简称	市值 (亿元)	EPS			PE			PB	周涨跌幅 (%)
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E		
688530.SH	欧莱新材	66.67	0.18	-0.25	0.7685	0.28	-0.40	1.23	8.07	28.30
688593.SH	新相微	175.22	0.02	-	0.2048	0.07	-	0.94	11.33	23.84
688661.SH	和林微纳	157.36	-0.07	0.37	1.0529	-0.09	0.57	1.60	12.71	22.07
688432.SH	有研硅	220.80	0.19	-	-	2.69	-	-	4.88	20.96
688048.SH	长光华芯	281.77	-0.57	-	0.44	-0.98	-	0.78	9.38	19.24
301536.SZ	星宸科技	353.10	0.61	0.67	1.0561	2.56	2.82	4.46	11.30	18.00
688325.SH	赛微微电	100.49	0.93	-	-	0.79	-	-	5.84	16.54
600206.SH	有研新材	219.85	0.17	-	-	-0.33	-	-	5.19	16.09
688409.SH	富创精密	340.57	0.66	0.51	1.0661	1.65	1.56	3.26	7.40	14.17
688216.SH	气派科技	39.79	-0.95	-	-	-1.06	-	-	5.40	13.78

资料来源：wind，华鑫证券研究

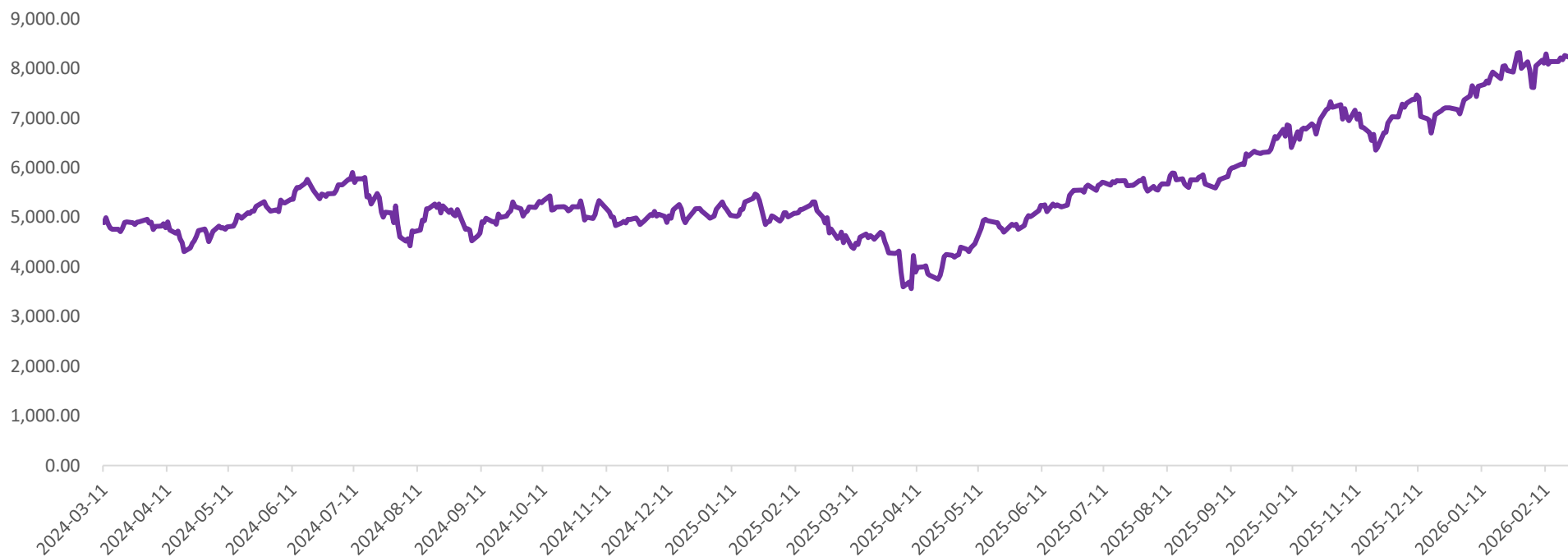
02 行业高频数据

研究创造价值

2.1、半导体：费城半导体指数

海外方面，2月23日-2月27日当周，费城半导体指数总体呈现震荡下跌的态势，在2026年2月26日出现大幅下跌，近两周整体呈现震荡的态势。更长时间维度上来看，2023年年底开始持续上涨。2024年上半年整体处于上升态势，7月出现大幅回调，8月处于震荡下行行情，9月出现探底回升，四季度总体处于震荡的态势。2025年一季度呈现先涨后跌的走势，4月后逐渐回升，二季度三季度均呈现震荡上行的态势。

图表8：费城半导体指数近两年走势

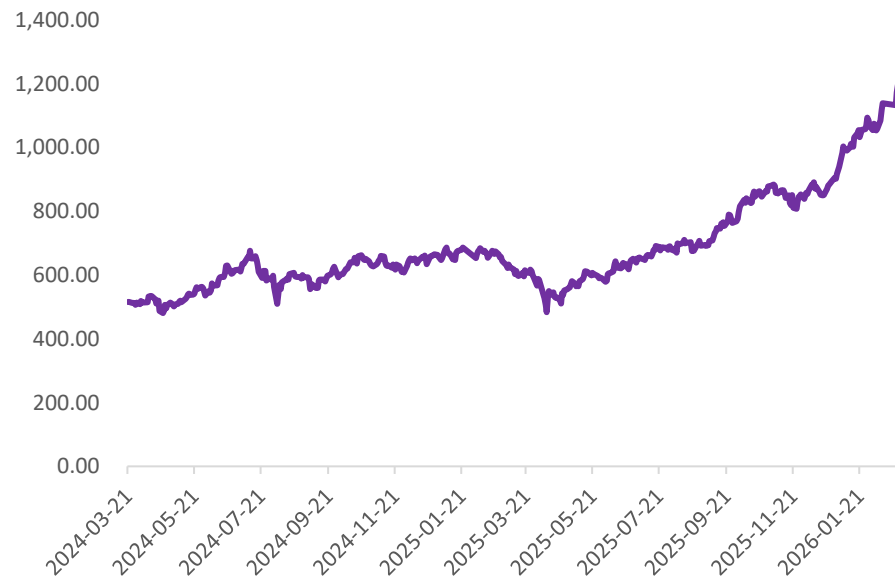


资料来源：wind，华鑫证券研究

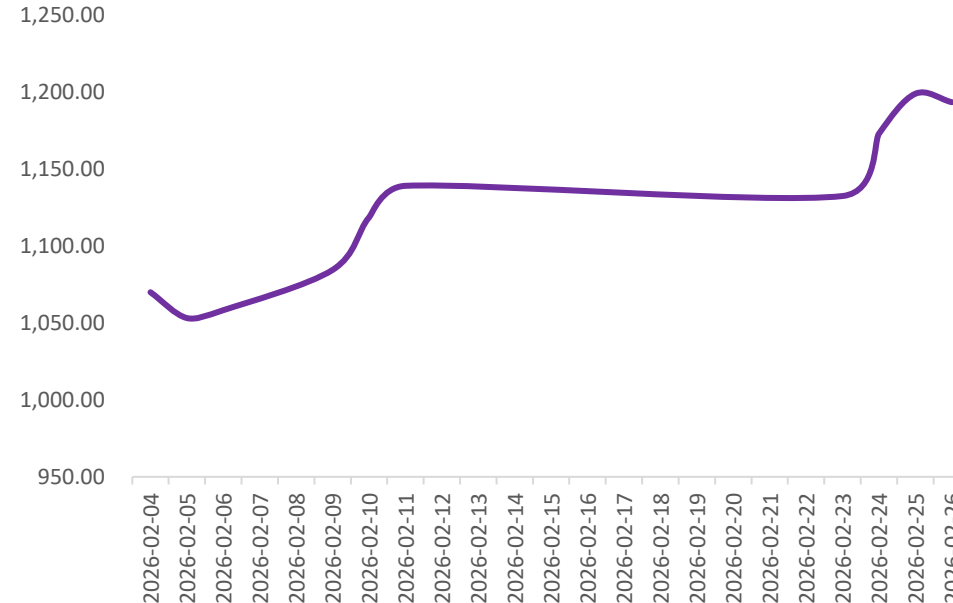
2.2、半导体：台湾半导体行业

此外，我们选取台湾半导体行业指数来观察行业整体景气。近两周来看，2月16日-2月27日两周，台湾半导体行业指数呈现整体上涨的态势。近两年来看，2024年二季度台湾半导体指数呈现上涨的态势，随后进入震荡行情。2025年一季度台湾半导体指数进入下跌的行情，随后进入上行的态势。

图表9：台湾半导体行业指数近两年走势



图表10：台湾半导体行业指数近两周走势



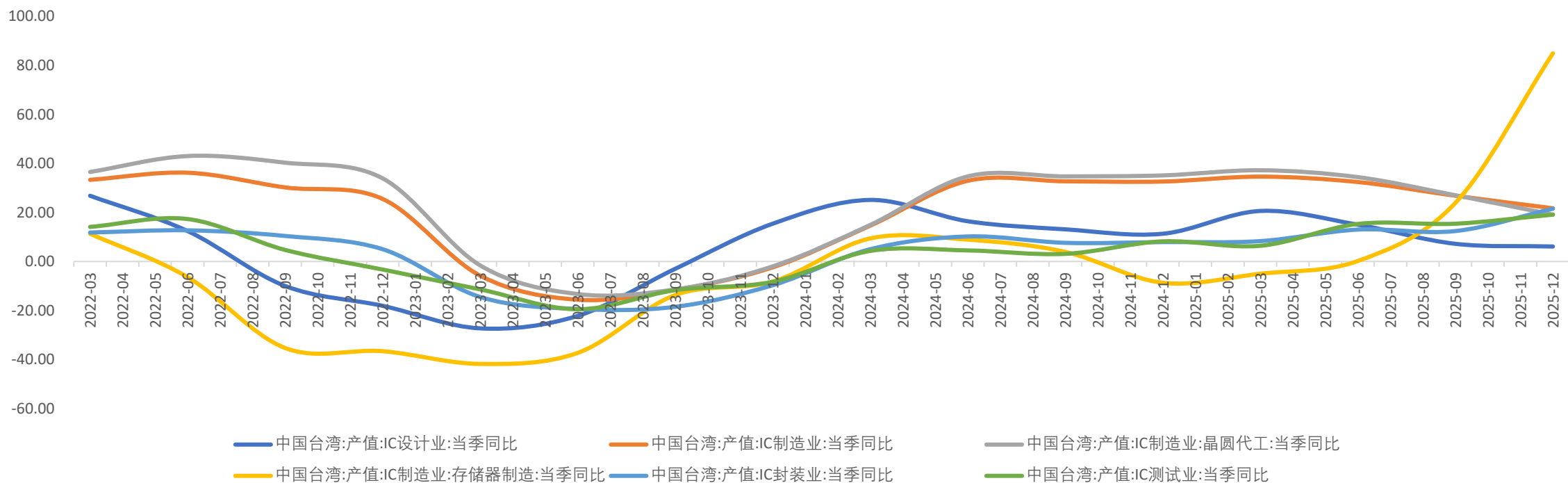
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.3、半导体：中国台湾IC产值同比增速

我们可以通过中国台湾IC产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：

中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年以来持续下降，从2023年Q2开始陆续有所反弹，各板块产值降幅均有所收窄。IC板块整体表现不佳，主要因为消费电子需求差，导致IC设计下滑，加之2021年缺货、涨价导致的2022年库存水位上升。但随着AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，2024年需求开始逐步回升。2025年，中国台湾IC设计、IC制造以及晶圆代工产值同比增速小幅下滑；中国台湾IC封装、测试业产值同比增速为维持平稳的增速；中国台湾存储器制造业进入下半年来，产值同比大幅提升。

图表11：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）

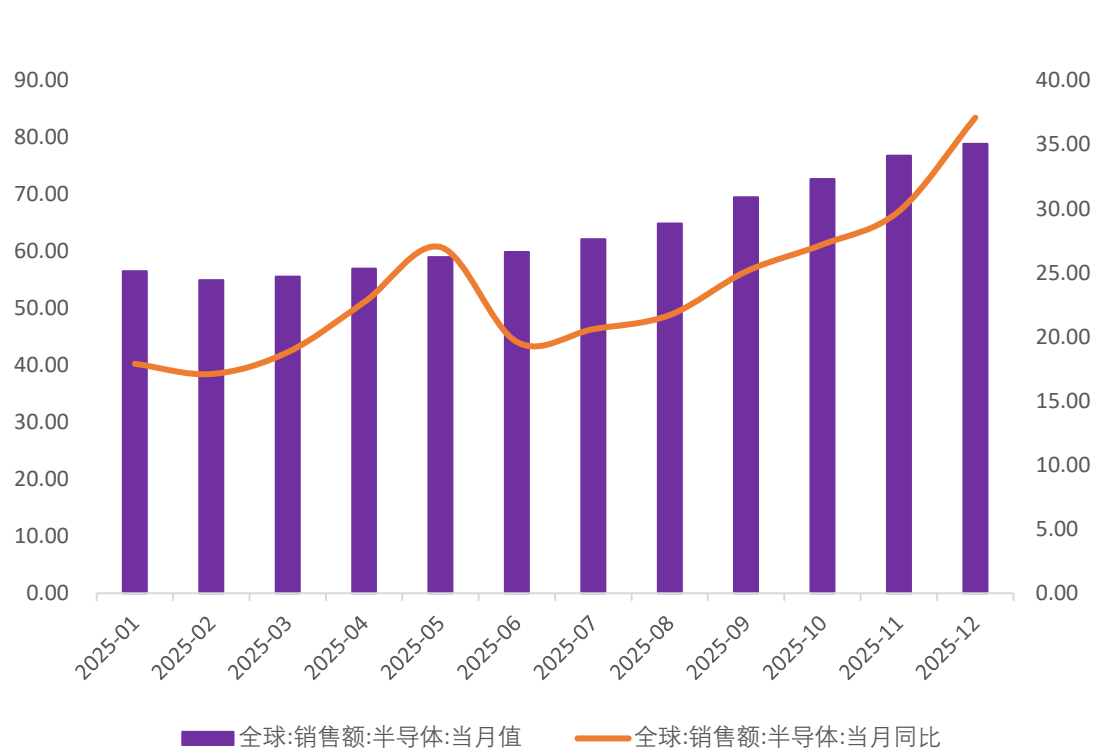


资料来源：wind，华鑫证券研究

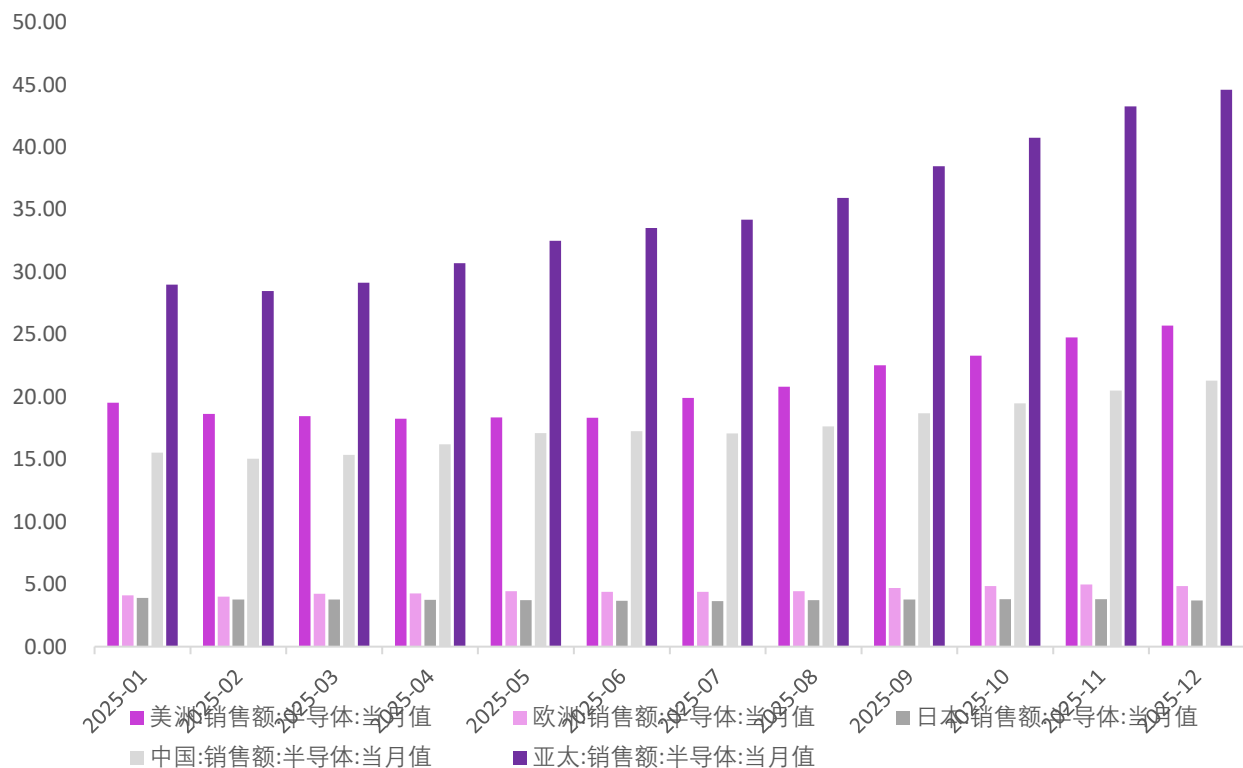
2.4、半导体：全球半导体销售额

全球半导体销售额自2024年年底出现小幅下降。2025年4月以来，全球半导体销售额呈现逐月攀升的态势，半导体行业景气度提升显著，2025年6月增速开始放缓，7-10月增速开始回升。2025年12月，全球半导体当月销售额为788.8亿美元，同比增长37.1%。其中，中国销售额为212.9亿美元，环比增长3.8%，占比达26.99%。

图表12：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



图表13：全球半导体销售额按地区划分（单位：十亿美元）



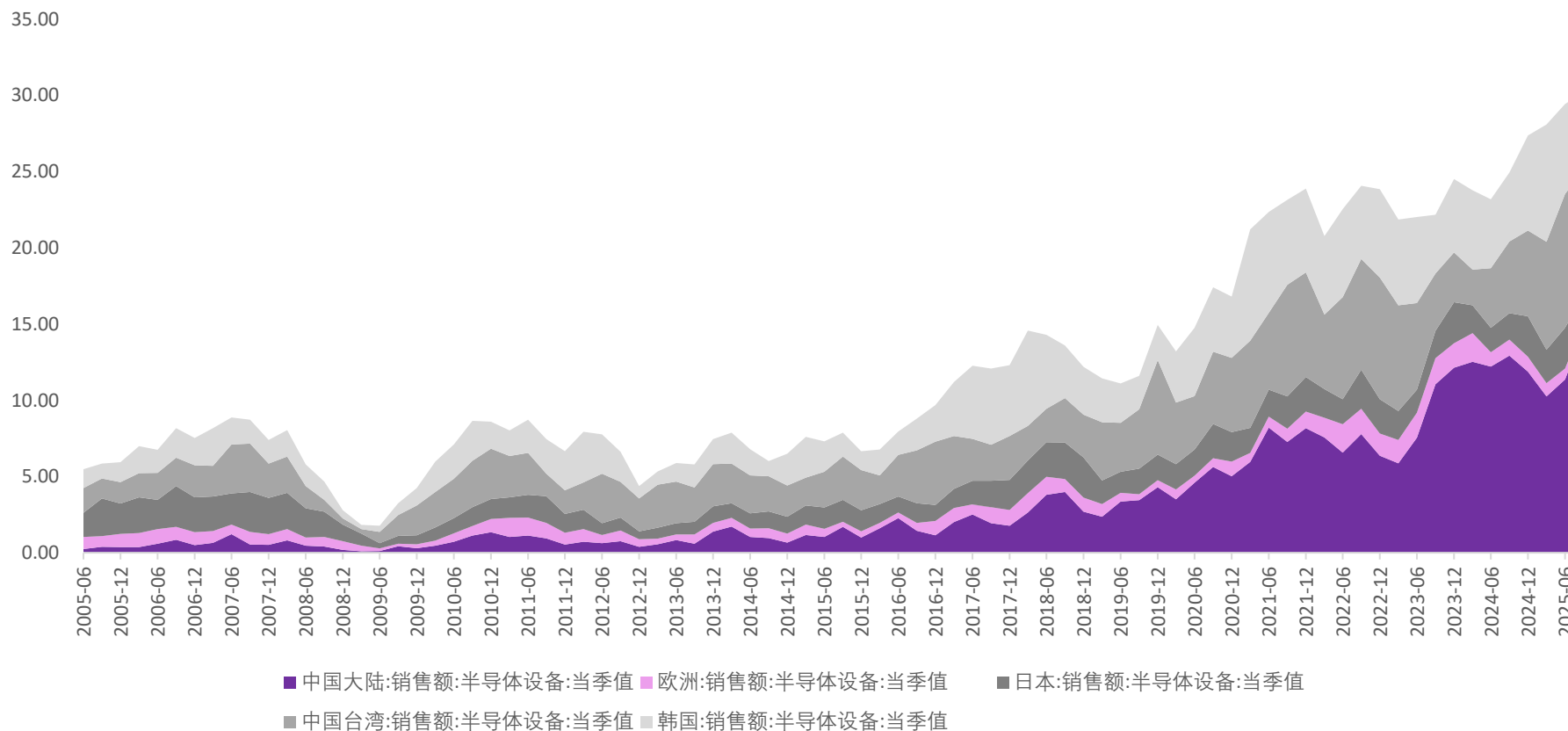
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.5、半导体：全球主要地区的半导体设备当季销售额

2005年以来，全球主要地区的半导体设备当季销售额呈现上升的趋势。2008~2009年，受全球金融危机等因素影响，各地区半导体设备销售额大多出现下滑。2020~2025年，随着5G、人工智能等技术发展带来的半导体需求增加，全球半导体整体呈现增长态势，中国大陆和中国台湾增长较为显著。

2025年三季度，中国大陆半导体设备销售额达到145.6亿美元，同比增长12.61%，环比增长28.17%。

图表14：全球半导体设备销售额（十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.6、半导体：中国进口半导体设备数量

从中国进口半导体设备数量的维度来看，2023年以来，中国的半导体设备进口数量整体呈现平稳的态势。结合上文中国大陆半导体设备销售额攀升的趋势，我们认为国产设备正在逐步提升市场份额。

图表15：中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量（台）

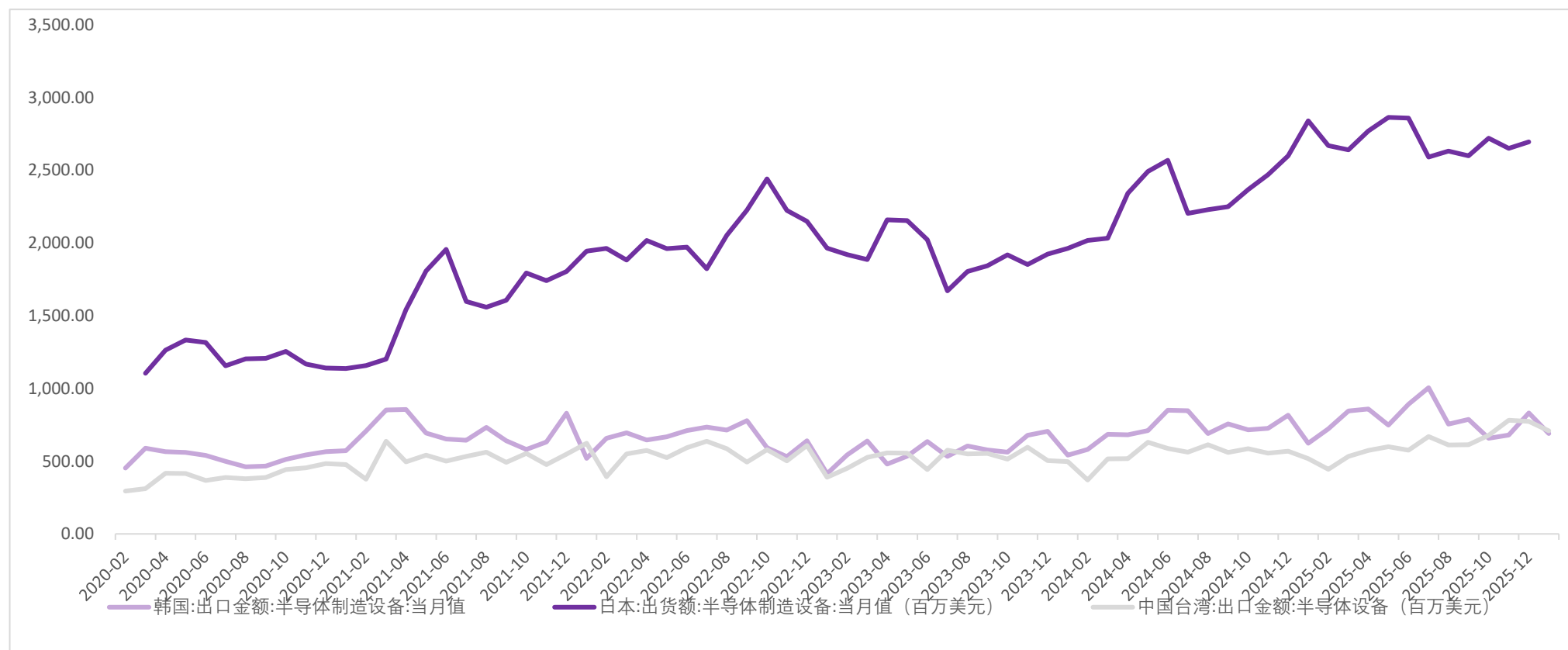


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.7、半导体：海外市场半导体设备出口额

从海外市场半导体设备出口额的维度来看，2019年以来，韩国和中国台湾的半导体设备出口金额整体维持平稳的态势，日本半导体设备出口额整体呈现上升趋势。

图表16：海外市场半导体设备出口金额（百万美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

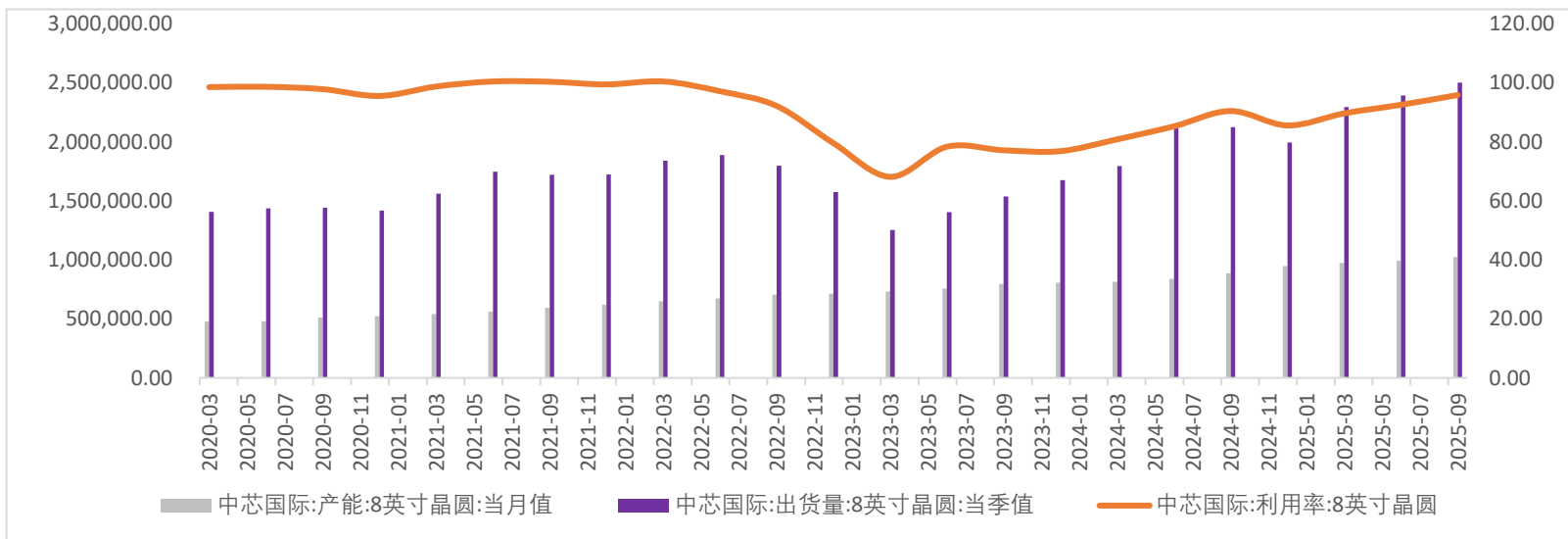
2.8、半导体：晶圆制造

晶圆制造方面，2018年至2025年9月，国产晶圆代工厂商中芯国际8英寸晶圆月产能从约45万片稳步提升至约102.3万片，实现翻倍以上增长，并历经稳步爬升、加速扩张及快速扩产三个阶段，尤其在行业调整期间中芯仍坚持逆周期布局，为后续复苏储备了充足产能。

产能利用率清晰地映射行业周期，从2020-2022年高景气期多次超过100%，到2023年下行期下滑至68.1%，随后自2023年第三季度起强劲反弹，至2025年第三季度已恢复至95.8%的高位，接近满产状态。在产能大幅扩张与利用率快速回升的共同推动下，季度出货量规模显著跃升，2025年第三季度达到近250万片，创历史新高，即便利用率未及上轮峰值，实际产出总量已远超以往。

整体来看，国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握了复苏机遇，出货规模的突破体现规模效应增强，也印证了汽车电子、工业控制、物联网等领域对成熟制程芯片需求的持续性与增长潜力。

图表17：国产晶圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据（单位：片）

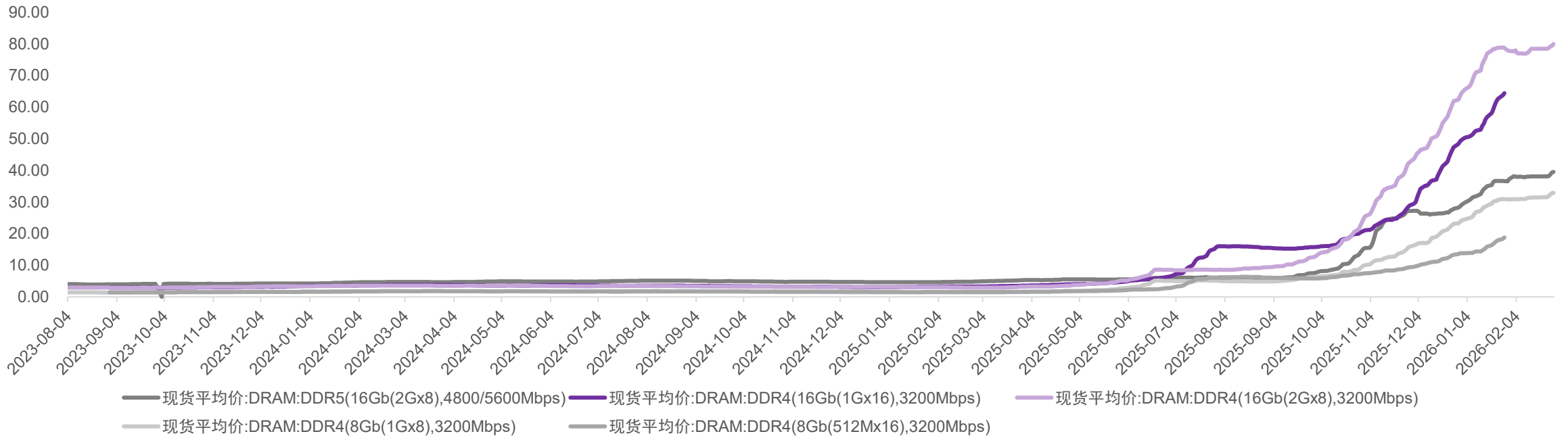


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

存储芯片方面，由于AI存力需求提升以及海外大厂产能切换HBM等缘故，导致传统DRAM以及NAND类存储芯片价格大幅攀升。NAND方面：Wafer:512GbTLC现货均价从2024年3月底进入小幅回升，10月出现小幅下跌后变化趋于平缓，2025年3月以来小幅上涨，4月后价格略有下滑，7月后价格进入加速上涨阶段。2026年2月09日价格为17.95美元。DRAM方面：DRAM:DDR5(16Gb(8Gx2),4800Mbps)现货均价从2024年3月以来价格小幅上涨，9月之后呈现小幅下跌态势，9月之后又重回下跌态势，2025年1月以来呈现大幅上涨的态势，12月初出现小幅下跌，之后开始进入加速上涨阶段。2026年2月27日价格为39.50美元。

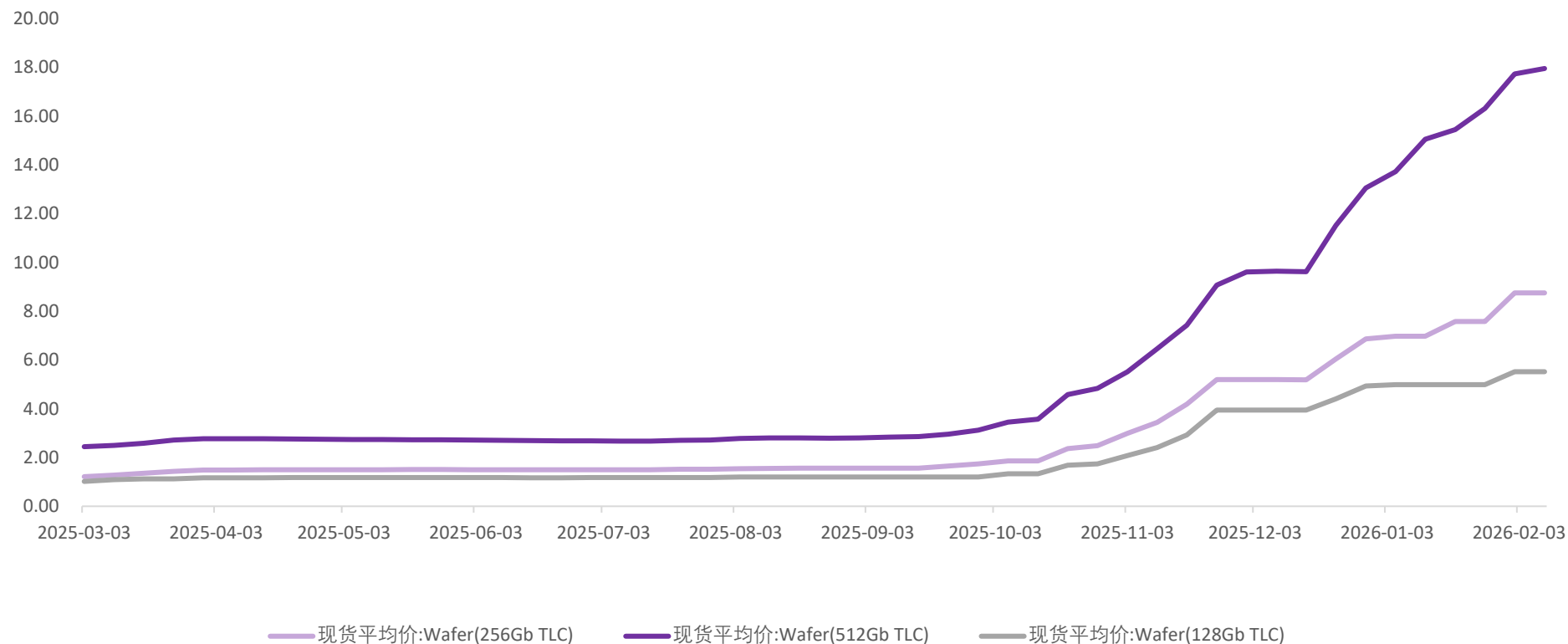
图表18：DRAM价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

图表19：NAND价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

03 行业动态

研究创造价值

Mac mini开启美国造，苹果今年将从台积电美国厂采购1亿颗芯片

当地时间2月24日，苹果公司宣布大幅扩建其位于休斯顿的代工厂，首次将Mac mini的未来生产引入美国本土。该公司还将扩大该工厂先进人工智能服务器的生产规模，并于今年晚些时候在其新建的先进制造中心提供实践培训。苹果在休斯顿的各项举措预计将创造数千个就业岗位。此外，苹果公司还透露，今年有望从台积电亚利桑那州晶圆厂采购超过1亿颗在美国制造的芯片。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示：“苹果公司始终致力于美国制造业的未来发展，我们很自豪能够大幅扩大在休斯顿的产能，Mac mini 将于今年晚些时候开始投产。我们已经提前从休斯顿开始交付先进的人工智能服务器，我们很高兴能够进一步加快这项工作。”

高通在印度研发的2nm芯片成功流片

据印度媒体报道，高通公司在2月7日宣布，通过其位于印度班加罗尔、钦奈和海得拉巴的研发中心，成功实现其2nm芯片设计的“Tap Out”，这对于印度半导体产业是一项重大推动，凸显了印度在全球尖端芯片设计领域的地位正在提升。

据介绍，高通的这款2nm芯片拥有数百亿个晶体管，集成了CPU和GPU，能够驱动从摄像头到自动驾驶车辆的人工智能设备。瓦伊什纳乌表示：“印度正越来越成为先进半导体技术未来设计的核心。在这里看到高通的作品、其工程实力、深厚的设计能力以及对印度的长期承诺，令人印象深刻。这样的里程碑，反映了印度朝着端到端半导体能力的进展，从后台角色转向完整的芯片设计、流片和验证，展示了印度芯片设计生态系统的日益成熟，这与印度政府打造具备全球竞争力半导体产业的愿景高度契合。”

高通公司也表示，这一成就反映了其在印度工程影响力的深度，如今印度已经是高通在美国本土以外拥有最大的影响力的地区之一，凸显了印度在先进半导体创新领域不断扩大的角色。

全球最快ADC芯片，发布

在近日举办的 ISSCC 2026 上，比利时微电子研究中心（imec）发布一款7位、175GS/s 模数转换器（ADC），采用5纳米 FinFET 工艺，核心面积仅 250×250 平方微米，转换功耗低至 2.2 皮焦 / 采样，采样速率位居全球公开报道前列。

该产品基于 imec 2024 年推出的时间交织斜坡型 ADC 架构升级，通过专利线性化技术和开关输入缓冲器两大创新，解决了超高速采样下芯片面积与功耗激增的行业痛点，可满足 AI 与云计算驱动的数据中心光通信高吞吐量需求。

imec 表示，正基于 3 纳米工艺开发下一代 ADC，并探索 14 埃工艺方案，目标向 300GS/s 及更高速率迈进。

ASML拟将EUV光源提升至1000W，晶圆产能可提升50%

2月24日消息，据路透社报道，荷兰光刻机大厂ASML在极紫外光（EUV）技术上取得了新的关键进展，计划将光源功率由600W提升至1000W。

而一旦EUV光源提升至1000W，ASML的EUV光刻机的产能就可由每220片提升至330片，单位产出成本则基本维持不变。

也就是说，在既有产线架构与空间条件下，仅通过对EUV光刻机的升级，即可实现约50%的产能增长，将直接改善晶圆厂的营运效率与资本支出配置结构。

ASML 技术主管Michael Purvis 表示，这套1000W光源系统并非短时间实验成果，而是在符合客户量产环境所有条件下，能稳定运作的完整解决方案。他强调，该技术已达可实际部署标准，而非仅止于实验展示。

受益于HBM4销售增长，三星重夺DRAM市场霸主地位

2月22日消息，三星电子宣布成功重夺全球DRAM市场第一名，这也是三星电子自2024年第四季以来首次重新夺回第一的宝座。根据市场调查机构Omdia的报告，三星电子2025年第四季DRAM市占率达36.6%，SK海力士以32.9%屈居第二，主要得益于三星第六代高带宽内存HBM4的销售增长。

报告指出，2025年第四季全球DRAM市场总收入达524.7亿美元，较前一季增长约120亿美元。三星DRAM销售额达191.56亿美元，较前一季增长40.6%。SK海力士销售额虽然增长25.2%达172.26亿美元，但市占率却从34.1%降至32.9%。三星电子过去一年来由于在HBM市场的失利，失去了DRAM市场领导地位，使得三星电子自1992年以来首次被SK海力士挤下第一的宝座。2025年第四季时，三星电子利用最大产能，以HBM3E和DRAM涨价重夺市场领导地位。

三星电子在最近财报会议上还表示，2025年第四季HBM销售额增长显著（外界认为这主要得益于其HBM4的销售额的增长），且高容量DDR5和低功耗高性能DRAM（LPDDR5X）等高附加值产品的需求也有上升。此外，三星电子HBM4速度高达13Gbps，搭载英伟达最新AI加速器。业界预估，三星电子将扩大对英伟达及其他全球大型科技公司HBM供应，今年整体HBM市占率将达约30%，HBM销售额比去年增长三倍。SK海力士也预定之后加强对英伟达的供应，以保持HBM市场主导地位。

3.6、行业动态整理

5nm，全球首款6G芯片发布

近日，博通正式宣布推出BroadPeak™射频数字前端（DFE）系统级芯片（SoC）。该芯片凭借高集成度优势，为5G大规模多输入多输出（MIMO）及射频拉远单元（RRH）应用解锁全新发展空间，同时为下一代5G-A（5G Advanced）与6G无线通信基础设施的建设铺平道路。

大规模MIMO是5G通信的核心使能技术，其核心价值在于提升移动网络的覆盖范围、网络容量及用户终端吞吐量。当前，在人工智能应用快速普及、用户对高速网络体验需求持续升级的双重驱动下，移动数据流量呈现爆发式增长态势，而移动运营商迫切需要全新的频谱资源与射频架构解决方案，以高效提升网络容量与传输速率，应对日益增长的网络需求。

作为一款面向未来的核心芯片，BroadPeak采用5nm先进CMOS工艺制程，在单芯片内高度集成业界领先的数字前端（DFE）与模数/数模转换（ADC/DAC）模块，相较于当前主流的大规模MIMO及RRH解决方案，其功耗最高可降低40%。不仅如此，该芯片具备优异的射频性能，覆盖400MHz至8.5GHz的超宽工作频段，成为业内首款真正面向大规模MIMO与RRH应用需求的5G-A及6G标准级产品。

针对5G-A标准，BroadPeak芯片可支持6.425–7.125GHz n104高频段；针对6G标准，则可兼容7–8.5GHz上中频段。依托该芯片的核心支撑，移动运营商与通信设备厂商可提前布局下一代大容量、高速率无线通信网络的研发与设计，为人工智能驱动的各类应用落地及个性化数字体验升级提供强有力的网络保障。

三星DRAM涨价100%：苹果买单，三星手机“挨刀”

当地时间2月25日，三星电子在美国旧金山举行了“Galaxy Unpacked 2026”发布会，正式发布了年度旗舰智能手机Galaxy S26系列，包括三款机型：Galaxy S26、Galaxy S26+（Plus）和Galaxy S26 Ultra。定价方面，由于存储芯片成本大幅上涨，Galaxy S26和Galaxy S26+的起售价相比上代都上涨了100美元，分别为899美元起和1099美元起。Galaxy S26 Ultra的起售价则与上代持平，为1299美元起。国行版Galaxy S26系列的起售价为6999元起。

虽然三星电子拥有强大的垂直整合能力，但由于内部各部门的独立核算，在存储芯片供应紧缺及市场价格大幅上涨的背景下，负责三星智能手机的MX（移动体验）部门并未从强势的负载三星半导体业务的DS部门那里获得较好的商务条款，使得三星MX部门不得不找找美光作为DRAM的第二供应来源。

根据韩媒Dealsite透露，三星DS部门之所以不愿降价向DX部门提供DRAM芯片，主要是由于DS部门刚刚获得了一项重大商务谈判的胜利，即成功对苹果供应的DRAM涨价100%。

一位半导体行业人士表示，三星电子DS部门最初的策略是将苹果iPhone使用的LPDDR5X内存价格提高约60%，然而，在第一次谈判桌上，三星首先提出涨价100%，苹果立即接受了这一提议。

SK集团董事长：将扩大HBM产能以应对需求激增

当地时间2月20日，在华盛顿第五届跨太平洋对话会议上，SK集团董事长崔泰源承诺将大幅提HBM（高带宽内存）产量，以应付全球数据中心需求。崔泰源形容HBM为“怪兽新片”，对人工智能（AI）产业非常重要。

崔泰源强调，SK海力士需要加速量产最新HBM4——推叠16枚DRAM片的最新一代高带宽内存，利润率达约60%。HBM是“真正赚大钱的产品”，今年供应短缺会超过30%。

崔泰源最近与多家美国科技公司负责人会面，包括英伟达CEO黄仁勋、Meta CEO扎克伯格、谷歌CEO桑达尔·皮查伊、微软CEO萨提亚·纳德拉和博通CEO陈福阳，为其内存供应短缺表示歉意。

SK海力士目前在HBM市场的份额约60%，处于主导地位。为NVIDIA的AI加速器如Blackwell和Rubin提供动力，并产能满载至今年。

04 公 司 公 告

研究创造价值

中科寒武纪科技股份有限公司2025年度业绩快报公告

根据中科寒武纪科技股份有限公司发布的公告，报告期内，公司实现营业收入649,719.62万元，较上年同期增加532,273.18万元，同比增长453.21%。公司归属于母公司所有者的净利润为205,922.85万元，较上年同期扭亏为盈，主要系本期营业收入大幅增长所致。变动幅度超过20%以上指标的说明：1、公司营业总收入较上年同期增长453.21%，报告期内，受益于人工智能行业算力需求的持续攀升，公司凭借产品的优异竞争力持续拓展市场，积极推动人工智能应用场景落地，使得本期收入规模较上年同期大幅增长。2、公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均同比扭亏为盈，主要系本期营业收入大幅增长所致。3、基本每股收益、加权平均净资产收益率均由负转正，主要系本期归属于母公司所有者的净利润同比扭亏为盈所致。4、总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产较本报告期初分别增长100.14%、118.27%、116.09%，主要系本期收入规模大幅增长带动利润增长及公司2025年度向特定对象发行新股募集资金所致。

无锡芯朋微电子股份有限公司2025年度业绩快报公告

报告期内，公司2025年度实现营业收入114,272.05万元，较上年同期增长18.47%；实现营业利润18,834.87万元，较上年同期增长80.82%；实现利润总额18,508.73万元，较上年同期增长81.75%；实现归属于母公司所有者的净利润18,630.04万元，较上年同期增长67.34%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,587.38万元，较上年同期减少23.59%。报告期末，公司总资产330,844.49万元，较期初增长12.17%；归属于母公司的所有者权益272,570.18万元，较期初增长9.37%。

影响经营业绩的主要因素：公司以“半导体能源赛道”为核心战略方向，2025年度营业收入同比增长18.47%，主要得益于新兴市场（服务器/通信/工业电机/光储充/新能源车）营收同比大幅成长50%左右以及新品类产品（DC-DC、Driver、Digital PMIC、Power Device、Power Module）营收同比大幅增长39%左右。公司专注于为客户电源和电机系统提供整体解决方案，目前已基于五大核心技术（半导体高压器件/高低压集成工艺技术/数字电源技术/高密度功率封装技术/器件级失效分析技术）构筑出六大具备协同效应的产品线（AC-DC、DC-DC、Driver、Digital PMIC、Power Device、Power Module）架构，公司已从AC-DC模拟芯片供应商向电源电机系统芯片及解决方案供应商加速演进。

苏州晶方半导体科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告

本周，苏州晶方科技披露其2025年度利润分配方案公告

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1,993,001,628.08元。经董事会决议，公司2025年度利润分配预案为：2025年末公司总股本为652,171,706股，其中以集中竞价回购产生的库存股747,700股，2025年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库存股后的股本651,424,006股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计人民币78,170,880.72元。

富创精密:2025年度业绩快报公告

根据沈阳富创精密设备股份有限公司2025年度业绩快报公告，报告期末，公司实现营业总收入35.51亿元，同比增长16.81%；实现归属于母公司所有者的净利润-0.09亿元，同比下降104.61%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-0.49亿元，同比下降128.73%。报告期末，公司总资产89.29亿元，同比增长6.85%；归属于母公司的所有者权益44.88亿元，同比下降2.17%。

影响经营业绩的主要因素：（1）公司2025年度实现营业总收入35.51亿元，同比增长16.81%。作为国内半导体设备零部件领域领军企业，公司依托在先进制程领域的先发优势，持续提升重点客户市场份额，业务规模实现稳定增长；（2）公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-0.09亿元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-0.49亿元，利润阶段性承压，主要原因系，报告期内，公司围绕“产能布局、人才储备、技术研发”三大战略方向进行了前瞻性、高强度投入。相关战略性举措在夯实长期发展基础的同时，导致本报告期内成本及期间费用的刚性增加，对短期经营性利润造成一定压力；随着新增产能的逐步爬坡释放、研发成果的转化落地以及管理协同效率的进一步优化，公司的规模效应有望逐步显现，为未来提升持续盈利能力和高质量发展筑牢根基。

05 风 险 提 示

研究创造价值

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

吕卓阳：澳大利亚国立大学硕士，曾就职于方正证券，4年投研经验。2023年加入华鑫证券研究所，专注于半导体材料、半导体显示、碳化硅、汽车电子等领域研究。

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券

CHINA FORTUNE SECURITIES

研 究 创 造 价 值